

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-026

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、情况概述

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限公司2024年度审计报告》，截止2024年12月31日，公司经审计的实收股本为28,080.43万元，合并资产负债表中未分配利润为-38,505.20万元，未弥补亏损金额为38,505.20万元，超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东会审议。

#### 二、亏损原因

1、截至2024年12月31日，公司累计亏损金额38,505.20万元；

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-18,897.75万元，主要原因如下：

（1）市场竞争激烈，产品销售价格持续低迷。报告期内，公司电子元器件产品销售收入51,851.74万元，销售量149,668万只，销售量较上年同期增长了42.52%；产品均价约0.35元，与上年同期持平，仍处于较低水平，导致毛利率亦处于较低水平。

（2）根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，计提各项减值准备8,092.19万元。

#### 三、应对措施

1、深耕主营业务，提升核心竞争力

公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体、TCXO振荡器、OSC振荡器，在国内具备量产优势。随着新兴技术的发展，如物联网、5G通信、人工智能和自

动驾驶等，对晶振在小尺寸、高频率、低功耗等方面提出了更高的要求。公司将继续深耕附加值较高的高基频、小型化 SMD 谐振器及 TCXO 振荡器、TSX 热敏晶体等产品，不断完善产品种类、提升产品质量，以满足客户的不同需求。

## 2、优化体系建设，提升管理效率

公司将持续加强现代企业规范化管理体系建设，深入推进 6S 精益化生产管理。与此同时，运用 AI 助力，并不断完善公司内部控制建设，从采购、营销、生产、财务、IT、人力资源等环节为抓手，优化操作流程，提高企业运营效率。

## 3、紧跟市场需求，加速布局谋划

公司 2025 年将以改善生产经营为主要目标，密切关注市场动态，合理优化经营策略，深度整合渠道资源，加强市场拓展，提高营销效率，积极快速地响应客户需求，提升服务品质。客户方面，紧跟客户尤其是大客户的需求，致力于为客户提供更加满意的解决方案；人员管理方面，加强人才引进，激发组织能效，进一步推进组织优化与架构扁平，深度锻造组织韧性完善利益共享机制，进一步增强核心经营管理团队、营销团队与公司共同发展的价值理念。

## 4、强化内审监督，完善内控管理战略

在项目部、基地审计常态化的基础上，强化对新设项目经营风险的关注、监督、风险提示，确保新设项目风险审计全覆盖。同时，对重点项目部进行回头审计，夯实内审工作成效。结合合同审查、印章管理、审批程序核查等方面加强经营管理过程中的实质检查,并开展监督评价,确保经营管理合规、成本费用合理根据公司经营现状,对公司重要业务制度及流程进一步修订完善,降低公司经营风险。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日